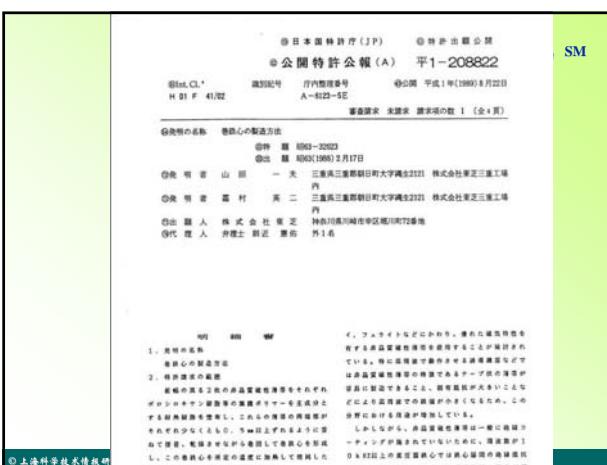


© 上海科学技术情报研究所



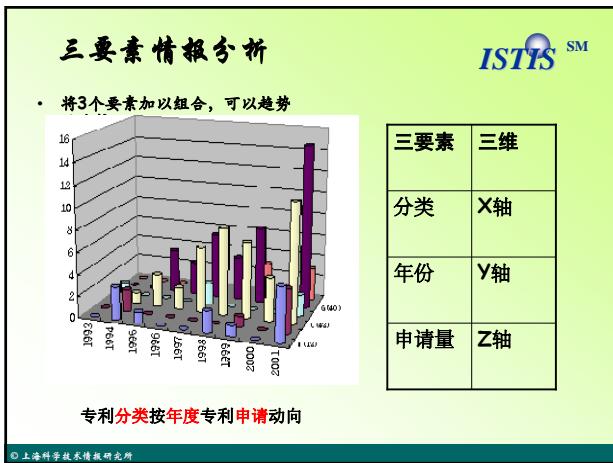
© 上海科学技术情报研究所



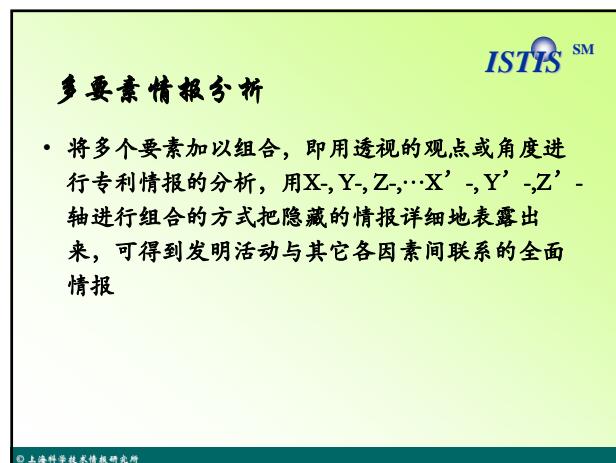
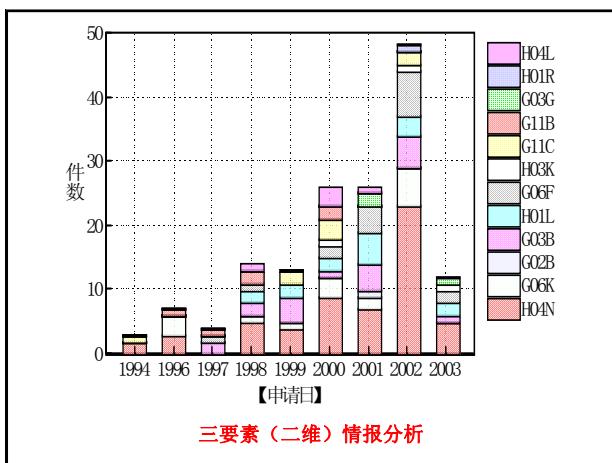
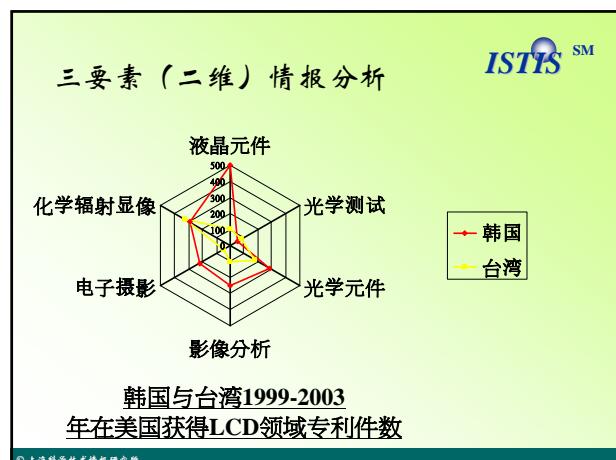
© 上海科学技术情报研究所

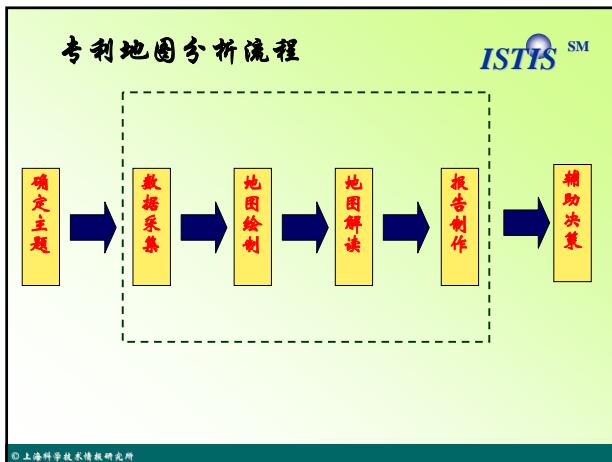
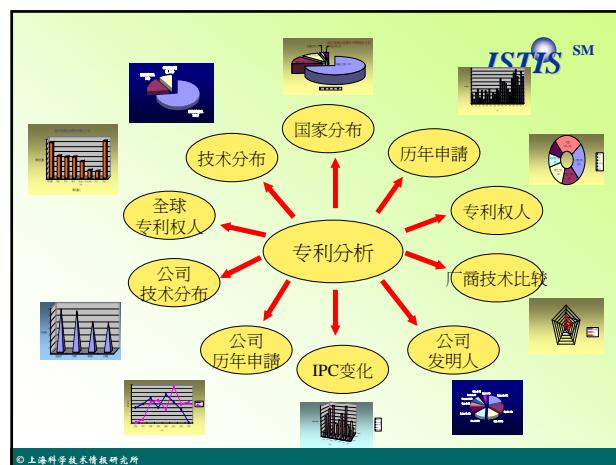


© 上海科学技术情报研究所



© 上海科学技术情报研究所





确定主题

ISTISSM

主题	描述
产品	整机或部件
技术	若干产品、方法、设备、原料等
申请人	研究竞争情报
发明人	研究研发情报
业界	若干申请人、技术等

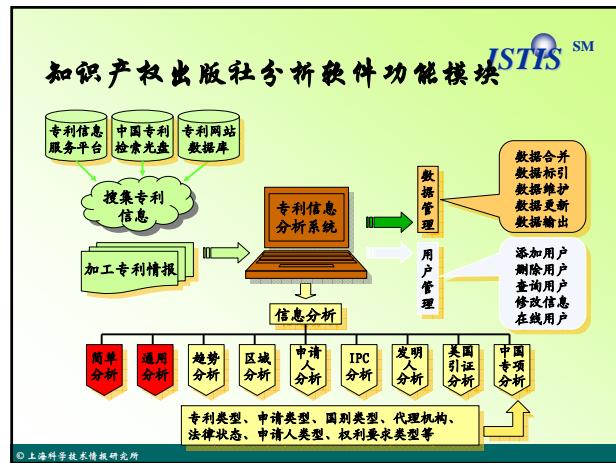
© 上海科学技术情报研究所

专利情报分析软件（国内）

ISTISSM

名称	内容
知识产权出版社	专利信息分析系统以竞争战略分析和专利信息分析的理论为模型，利用数理统计原理和最新软件技术来设计。系统主要包括以下主要功能：1、信息的采集与加工；2、信息的管理与维护；3、信息的检索与分析。
大为PatentEx	中、美、欧专利高速下载库；法律状态、同族专利下载；智能数据分类；存活期、技术生命周期、法律状态、增长率、矩阵、引证等专利分析；配合企业经营战略有效制定专利战略；辅助技术发展战略决策；监视对手动向，跟踪行业技术动态；挖掘行业核心专利技术。
东方贞盾	美国M.CAM DOORS专利信息平台基础上改进的中文界面的Eastlinden Doors专利战略分析平台，包含有50余个国家的4400万件专利文献和4000余万件非专利的科技文献。除基础信息外，还包含有多国的专利说明书全文、引证文献、同族专利、法律状态、技术转让信息等。
恒和硕	提供各个检索入口，支持逻辑检索；可连接欧专局、美专局、中国知识产权局数据库，可查询目录、说明书、摘要、权利要求、法律状态中的关键字、词，做标记建立子库；强大分析组合：发明人、申请人、国际IPC分类、欧洲分类、同族、公开（年）、优先权和自定义自由组合分析；引证分析：可快速建立两条专利数据的前向和后向专利引证模型，进行引证分析、统计图表；专利分析以柱状、饼、多维、矩阵图表表现；统计报告：自动生成多种Word统计报告，例如国际IPC分类、申请人等报告；导出功能：可将数据导出到Word、Txt、Xml、Excel。

© 上海科学技术情报研究所



专利情报分析软件（国外）	
名称	内容
INAS	韩国WinLAB有限公司根据专利地图理论开发的专利分析系统。该软件从免费的和付费检索到的专利信息（主要包括：中国专利局、美国专利局、DELPHION、日本专利局、欧洲专利局）中自动抽取信息并存储，然后利用INAS对数据进行转换、去重、编辑，查询数据，对文摘、权力申明、细节描述信息进行挖掘，进行专利的定量分析、定性分析、权力分析，并将分析结果以文本或者图像化方式展示出来。
patent-label	Wisdomain公司开发的分析IHW Intellectual Property Network上提供的专利的工具，利用patent-label可以解决以下问题：了解研究开发趋势；竞争对手的关键和新领域；竞争对手开发项目的最新进展；重要发明人的最新成果；竞争对手的技术潜力。主要功能：利用报告获得专利的总体概况；分析助手功能；专利原文浏览、分析结果的可视化展现（2维、3维图、饼图、蜘蛛图）。
Vantage Point	VantagePoint基于佐治亚技术研究所技术政策和评价中心多年的研究开发工作。主要功能：具有对新数据进行抽取和爬引功能；列出前十个发明人的功能；共现矩阵分析功能；图表显示、数据清洗工具、用户管理数据表等功能。目前VantagePoint为Thomson Scientific公司的德文特分析家提供数据挖掘和分析的软件支持。
Thomson Data Analyzer	美国Thomson公司开发，是Derwent Analytics的第二代产品。该软件具有自动化程度高、界面友好、直观的特点，从Derwent世界专利引和专利引文数据库中的原始数据中挖掘出最有用信息，为洞察技术发展趋势、掌握竞争对手的专利发展情况、找出更多的专利发明人及其供职的公司、发现行业近年来出现的技术、确定研究战略和未来方向等方面提供有价值的依据。

© 上海科学技术情报研究所



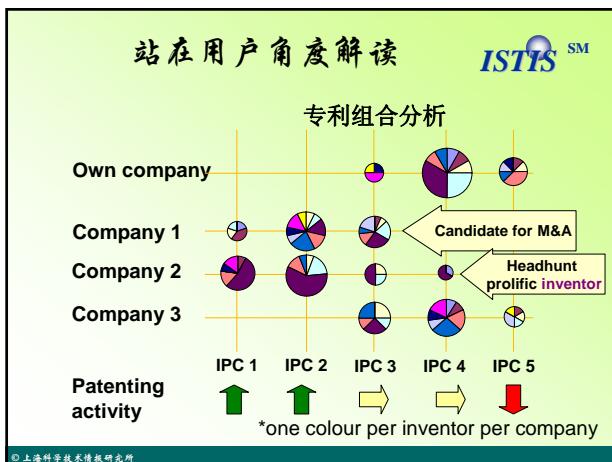
© 上海科学技术情报研究所



© 上海科学技术情报研究所

- ### 用户适用原则
- ISTIS SM
- **用户理解**
 - 比如用自然语言，而不用分类等情报语言（例：采用“垂直风力发动机”，而不用 F03D 1/00）
 - **用户立场**
 - 比如某一用户委托作专利地图，你就要站在其角度解读专利地图，说明应采取何种策略；非特定用户的行业专利地图，可以从不同的厂商分别描述。

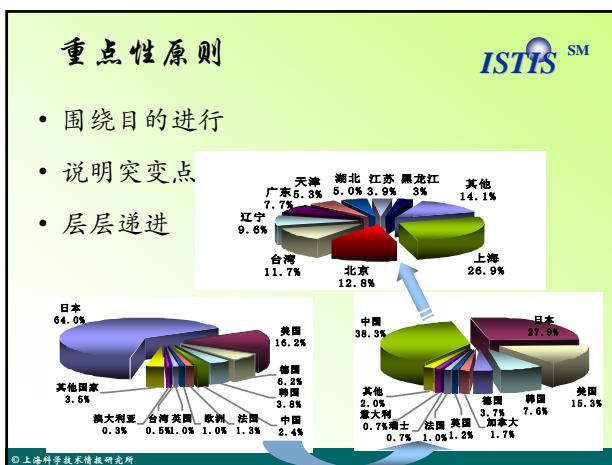
© 上海科学技术情报研究所



© 上海科学技术情报研究所

- ### 全面性原则
- ISTIS SM
- 结合其他途径获得的情报综合解读
 - 同一现象可以推出多种结果要全面反映
 - 如在美国关于某一技术领域申请了许多专利，可以推断这是产业化区，也是雷区

© 上海科学技术情报研究所



各专利地图解读重点各异

ISTISSM

类型	解读重点
技术地图	<ul style="list-style-type: none"> 了解技术开发脉络 了解新产品开发动向 选定研发课题 确定用途开发 进行技术挖洞 了解技术波及领域 把握标杆企业动向 把握新加入者情况 促进技术转让 提高专利调查精度
管理地图	<ul style="list-style-type: none"> 确认技术保护范围 专利申请战略的应用（考察获得专利的可能性） 专利网构筑 确定专利权期限 异议无效文献调研
权利地图	<ul style="list-style-type: none"> 确认技术保护范围 专利申请战略的应用（考察获得专利的可能性） 专利网构筑 确定专利权期限 异议无效文献调研

© 上海科学技术情报研究所

要素解读

ISTISSM

要素	解读
申请人	竞争者
发明人	研发人员
分类	自然语言表达的技术
权利要求	保护、障碍
专利量	市场

© 上海科学技术情报研究所

定性专利地图的解读

ISTISSM

- 主要针对专利文献具有的某种**技术思想**，判定同样技术思想的专利文献有哪些；时间方面，以前有怎样的专利文献，以后有怎样的专利文献，同期有怎样的专利文献等。即观察同类，观察关联，观察流向，观察发展过程。特别要解读出专利文献技术思想的不同之处，把握整体技术流向。

© 上海科学技术情报研究所

定量专利地图的解读

ISTISSM

角度	现象	解读例	
		技术面	人员面
专利件数	显著多	生命周期的成熟期	参与企业多
	比较多	技术开发成果多	参与开发者多
	比较少	生命周期的成长期	进入者少
	没有	未开发的技术	谁都没注意
专利件数变化	急剧增加	技术完成度高	开发者大量介入
	缓慢增加	技术接近实现	参与者逐步增多
	不变	开发稳步推进	参与者、撤退者未增
	慢慢减少	产生技术问题	出现撤退者
	急剧减少	大体完成或实现不可能	研究开发停止
专利件数比	非常大	该技术开发成果最大	参与者最多
	大	该技术开发成果较大	参与者较多
	大体相同	几项开发成果齐头并进	各技术投入人力相当
	小	该技术开发成果较小	参与者较少
	非常小	该技术开发成果最小	参与者很少

© 上海科学技术情报研究所

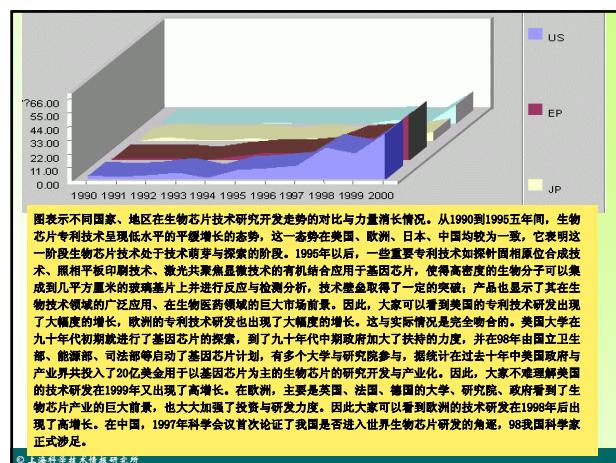
- ### 解读顺序
- ISTISSM
- 地图主题揭示
 - 坐标轴说明
 - 图形描述（形状、拐点、差异点）
 - 现象推出结论
 - 建议
 - 数据缺陷说明
- © 上海科学技术情报研究所

解读专利地图技巧

ISTISSM

- 再现（把图表内容用文字重点描述）
- 纠错（说明由于数据不足引起的图表问题）
- 解释（造成变化的原因）
- 联想（如专利量的增加描述成研发投入增加）
- 印证（与其他研究或现实情况相符）
- 比较（说明关键要素的反差）
- 推理（未来的情况）
- 建议（如何做）

© 上海科学技术情报研究所



专利地图应用与案例

ISTISSM

© 上海科学技术情报研究所

主要类型图

ISTISSM

类型	特点
专利技术图	突出技术，多为研发人员设计
专利管理图	突出管理，多为管理者设计
专利权利图	突出法律，多为法务人员设计

© 上海科学技术情报研究所

专利技术图

ISTISSM

- 1、技术生命周期、发展路径、发展动向与技术预测（时间序列）
- 2、关键（核心）技术分析（专利引文分析、专利群、同族专利、领域比重）
- 3、技术结构分析（产品分类、IPC分析、技术细分）
- 4、技术空白分析（技术／功效表，空间分析、论文与专利比较）
- 5、技术相关分析
- 6、技术参考（包括利用失效专利）

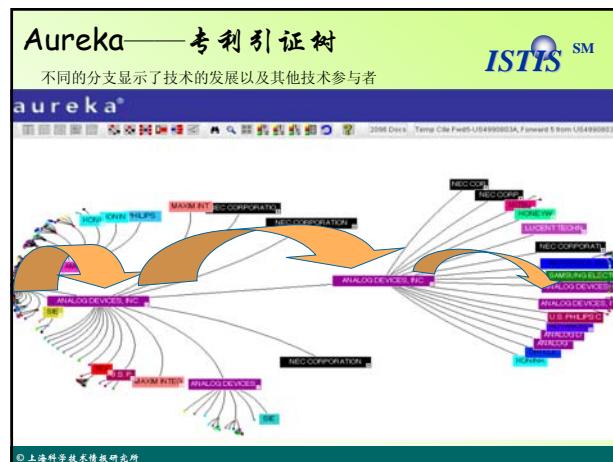
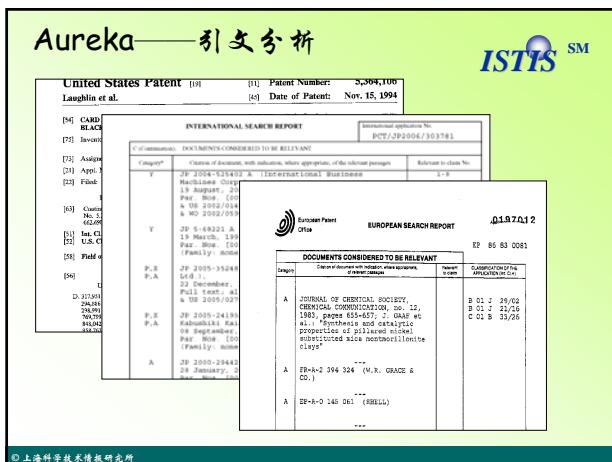
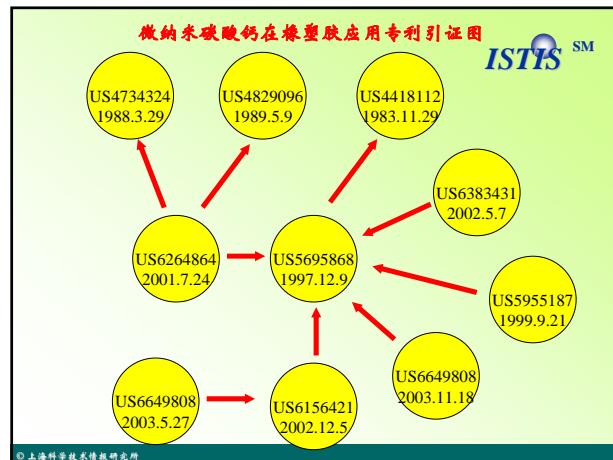
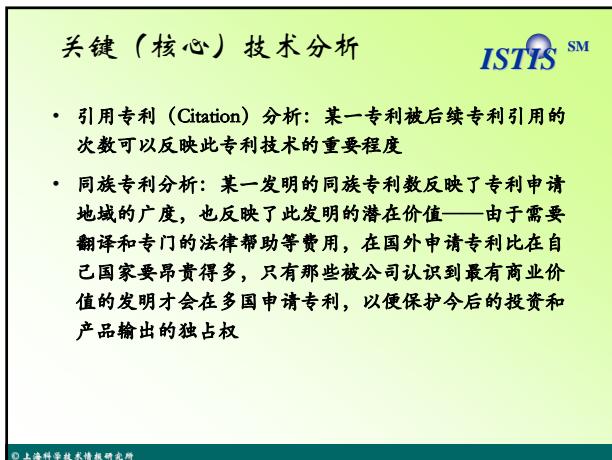
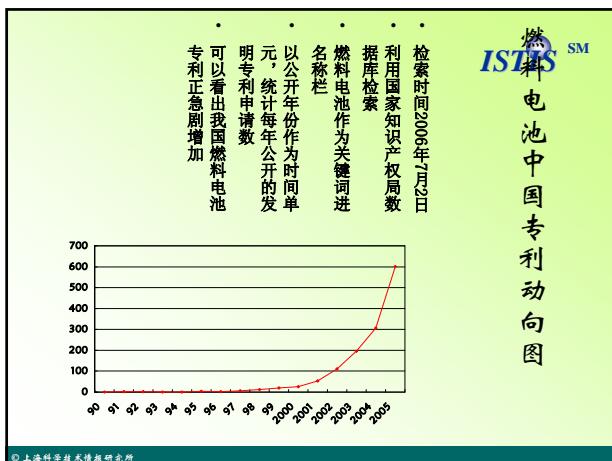
© 上海科学技术情报研究所

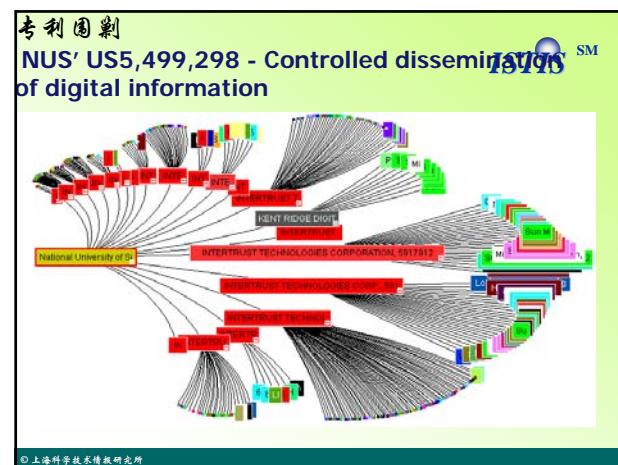
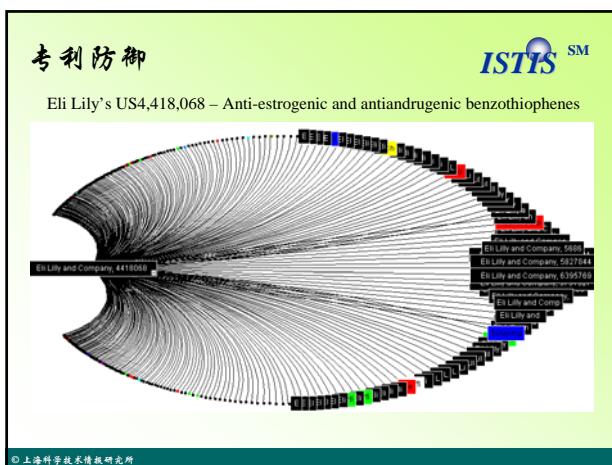
哪些技术有前途？
(专利技术按时间的分布研究)

ISTISSM

- 以时间为横轴、专利申请量(或批准量)为纵轴，统计专利量随时间的变化规律，透过历年专利动向图能看出该技术领域内，历年专利申请、产出及发展情况，并由此可推测研发投入趋势和技术发展趋势
- 任何技术都有一个产生、发展、成熟及衰老的过程，历年申请的专利数量、专利引文数量变化可以确定该技术的发展趋势及活跃时期
- 对不同技术领域的专利进行时间分布的对比研究，可以确定在某一时期内，哪些技术领域比较活跃，哪些技术领域处于停滞状态

© 上海科学技术情报研究所





专利技术/功效矩阵表

ISTISSM

- 横栏第一栏列出专利文献中所要达到的功效种类，纵列第一栏列出专利文献中采用的技术手段种类，而在表中央列出各专利编号。将某一技术领域的专利分别按照“技术”、“功效”所作的分类，一一填入适当空格内，即成为有专利空白区、疏松区、密集区的矩阵分布表。
- 主要作用：由矩阵表中各区域的密度分布，可看出技术密集区、地雷禁区，尚未被开发区域及有利可图的领域，分别找出这些区域所在位置，可进行挖洞技术或进行技术创新。对于地雷禁区，可进一步分析判断是否有回避设计的可能，或考虑同权利人交叉许可。
- 可找出本身技术（或设计）所在位置，察看该项目是否有其它竞争对手已取得专利，此可作为初步侵权判断的依据。最后，可根据表中侵权风险的技术区域、有利可图的区域、研发已呈饱和状态的区域等，拟定下一步的研发策略。

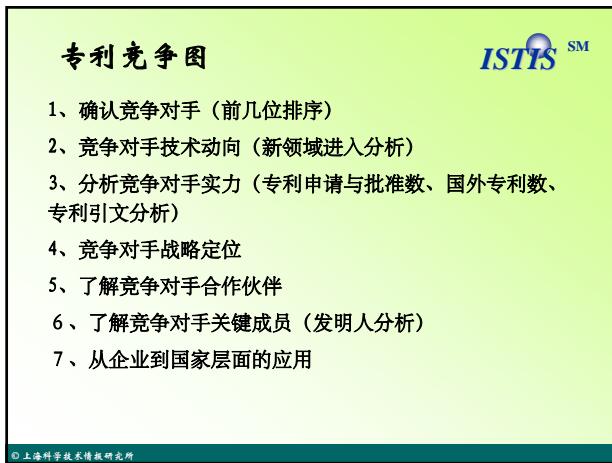
© 上海科学技术情报研究所

表 2-9 专利技术/功效矩阵表^[14]

SM

		电极设计	机构设计	密封设计	制程参数	电解液配方	电控技术	夹治具设计	电解复合研磨
		1	2	3	4	5	6	7	20
减少 电解液 使用	403094	403094	403094	386428	412749				537831
	403038	403038	403038	418899	415637				
	415637	415637	412459		517831				
	419213	419213	419213	415637		386428			
	430088	430088	430088	464511		418899			
	443101		513632			422412			
	464811		639715						
513632									
降低 成本	403094	403094	403094	403094	410679	414869	414869		
	403038	403038	403038	403038	5911867	410679	5911867		
	418899			494511	505411	566081	593411		
	440539		513632						
操作 安全	403094	403094	403094	403094	415637	422412	503245		
	403038	403038	403038	403038					
	464811	464811	421823	424511	418899				
	464898	464898	464898						
防止 漏气									

© 上海科学技术情报研究所





城市竞争力

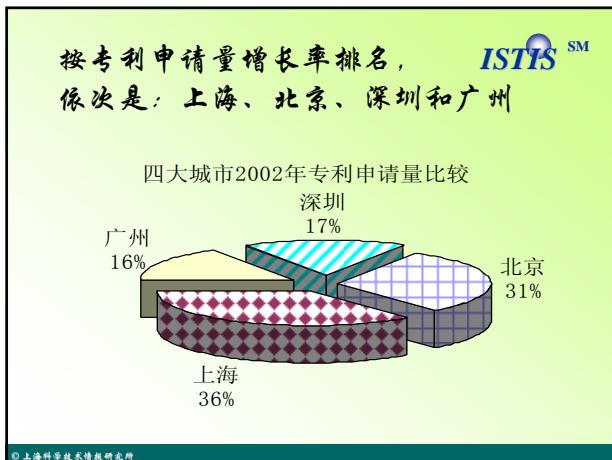
ISTISSM

中国社科院公布的一份中国城市竞争力报告
显示, 上海、深圳、广州和北京是中国最具城市
竞争力的四大城市

上海社科院的报告则显示, 上海、北京、深
圳和广州排在中国城市竞争力的前四位

中国国家统计局的综合实力排名前4位为上海、
北京、广州、深圳

© 上海科学技术情报研究所



企业竞争力

ISTISSM

- 从申请总量分析可以判断企业的综合实力。如2001年, IBM公司连续第9年成为获得美国专利数最多的公司, 共获美国专利与商标局颁发的专利34111项, 使得IBM成为美国历史上第一家在一年内所获专利数量超过3000项的公司。

© 上海科学技术情报研究所

2000年拥有美国专利数最多的10家公司排序

ISTISSM

排序	专利数	公司	国家
1	2886	IBM	美国
2	2020	NEC	日本
3	1890	Canon	日本
4	1441	三星	韩国
5	1411	Lucent	美国
6	1385	Sony	日本
7	1304	微技术	美国
8	1232	Toshiba	日本
9	1196	Motorola	美国
10	1147	Fujitsu	日本

© 上海科学技术情报研究所

竞争对手分析

ISTISSM

- 谁是竞争对手?
- 竞争对手有何技术特点?
- 竞争对手属于何种类型?

© 上海科学技术情报研究所

谁是竞争对手?

ISTIS SM

- 同类技术的专利申请人必然是竞争对手，故只要按各个申请人申请专利数量的多少进行排序，归纳和统计，就能得出本企业竞争对手名称的一览表。
- 对于一个企业而言，有的对手只是技术上的对手，比如著名的科研机构或高等院校，为了促进企业的技术更上一层楼，可采取与之合作的对策；有的对手是产品上的对手，如具有一定生产规模的企业，则应密切监视其技术产品开发动向，并采取相应的对策。

© 上海科学技术情报研究所

竞争对手有何技术特点?

ISTIS SM

日本工业技术研究院开发的重点是“H01基本电气元件”和“G01材料性质的测试测量方法”

Category	H01	G01	C07	B01	C08	G01	A61	C04	F28	G02	C12	C22	F24
日本工业技术研究院	350	330	230	170	130	120	110	110	90	80	80	70	70

© 上海科学技术情报研究所

比较

ISTIS SM

域亦有差异。由图 4-6 可见：索尼主要集中在 G11B7/00 和 G11B7/24；三星主要集中在 G11B7/12 和 G11B7/125；松下主要集中在 G11B7/00 和 G11B7/24；大宇主要集中在 G11B7/12 和 G11B7/135；三协精机主要集中在 G11B7/12 和 G11B7/135。

Company	G11B7/00	G11B7/12	G11B7/24	G11B7/125	G11B7/135
索尼	32	14	8	4	3
三星	16	17	1	2	1
松下	10	11	7	2	2
大宇	13	1	6	1	1
三协精机	14	1	10	1	1

图4-6 竞争公司IPC分类图

© 上海科学技术情报研究所

竞争对手属于何种类型?

ISTIS SM

表 3-4 公司定位分析表

	专利数	被引用次数	自己引用次数	引用他人次数	典型公司
技术先锋型	多	多	多	少或无	
自主开发型	多	少或无	多	少或无	
跟随型	多	少或无	少或无	多	
昙花一现型	少	少或无	少或无	少或无	

© 上海科学技术情报研究所

竞争态势一目了然

ISTIS SM

Result Set for Query: (elevator)

Activity Index - DVD Technology

Subject Area: Company: Subject Area: Activity Index

© 上海科学技术情报研究所

专利权利情报

ISTIS SM

- 谁拥有专利权（确认专利权人和受让人、交叉许可）
- 能否获得专利权（申请专利时的专利检索）
- 专利有效性（包括法律状态、时效性、地域性等）
- 专利侵权（主动侵权检索、被动侵权检索和权利范围）
- 自主知识产权认定（基础专利与从属专利）

© 上海科学技术情报研究所

案例研究

ISTISSM

- 燃料电池
- 色素增感型太阳电池（染料敏化纳米晶TiO₂太阳能电池）

© 上海科学技术情报研究所

燃料电池案例来源

ISTISSM

FUEL CELL TODAY
Opening doors to fuel cell commercialisation

**Fuel Cell Market Survey:
Patents, A Rich Vein of Knowledge**
Richard Seymour, Johnson Matthey - 27 February 2004

A Bit About Patents

The creation and success of new fuel cell technologies and ultimately a fuel cell industry depends in part on the ingenuity of scientists and engineers. It also depends on the investment necessary to develop new ideas and set up new enterprises, coupled with the ability to market them effectively. The granting of patent rights is a key part of this process because it gives legal recognition to the owner of new inventions and provides the owner with legal authority to stop others benefitting from his ingenuity and ultimately his market share, at least for a limited period of time (normally 20 years).

© 上海科学技术情报研究所

燃料电池总体发展

ISTISSM

Fuel Cell Patent Publications per year

Year	Patent Publications
1990	~100
1991	~150
1992	~200
1993	~250
1994	~300
1995	~350
1996	~400
1997	~450
1998	~500
1999	~550
2000	~600
2001	~1100
2002	~2400
2003	~2700

© 上海科学技术情报研究所

The picture below shows a visualisation of the 9132 fuel cell patents published since 1971. It was created using Aureka's® theme mapping tool, ThemeScape®, available from MicroPatent® LLC.

ISTISSM

- 根据词频自动集类专利和显示标题
- 黑点表示专利，鼠标指向时可以查看细节，甚至链接到说明书全文
- 山峰表示集类专利最多的地方，可以局部放大
- 等高线允许选择专利群供进一步分析
- 山峰会显示专利密集区，产业化区，雷区
- 海洋部分几乎没有专利，研究区，空白区

© 上海科学技术情报研究所

地图可以利用主题词和公司名检索
Ballard (红点) ; Plug Power (绿点) ; DaimlerChrysler (黄点)

ISTISSM

比较公司的专利活动

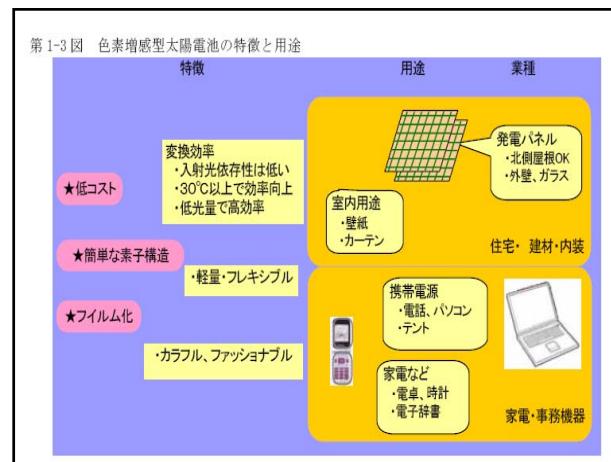
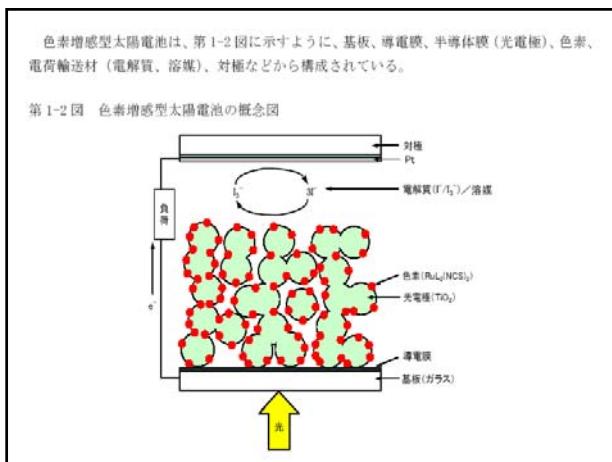
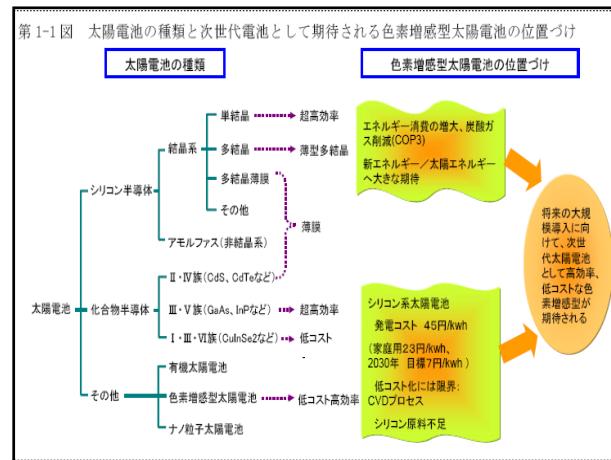
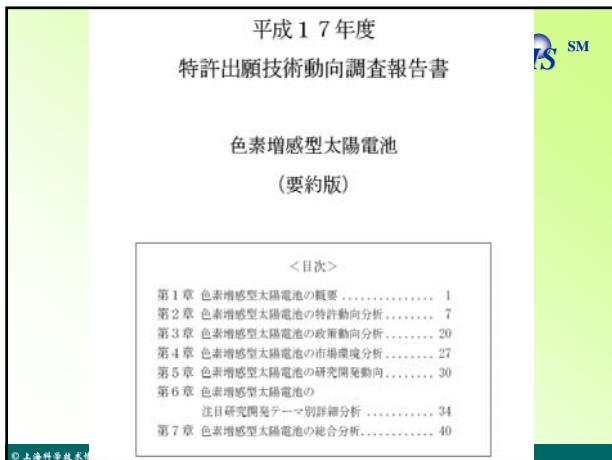
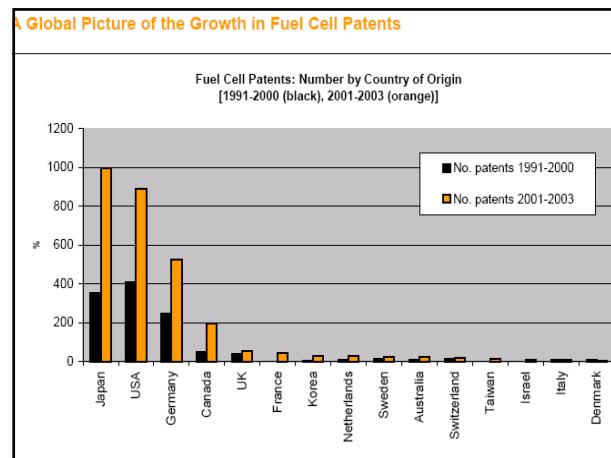
© 上海科学技术情报研究所

国家比较

• 红点表示英国公司
• 绿点代表法国公司

ISTISSM

© 上海科学技术情报研究所



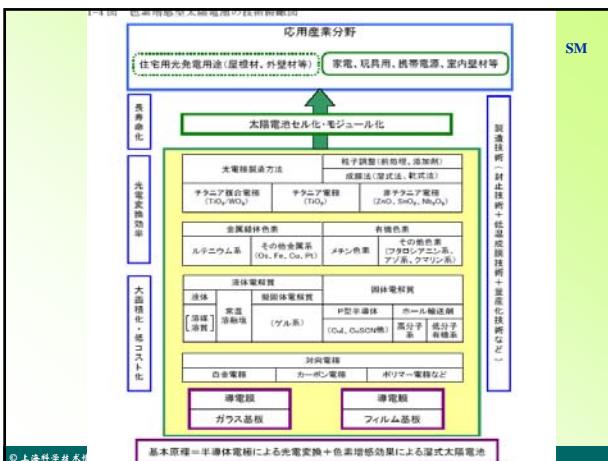
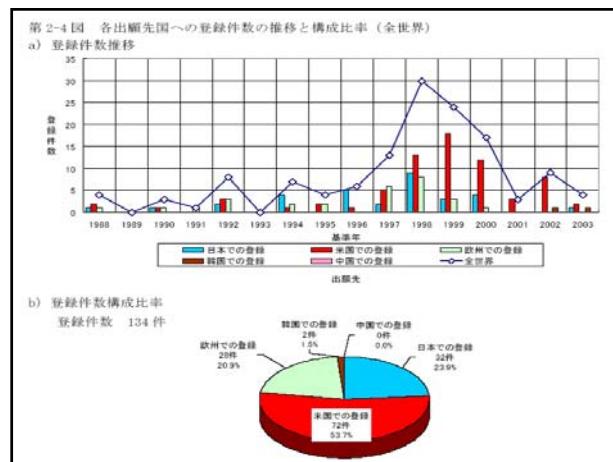
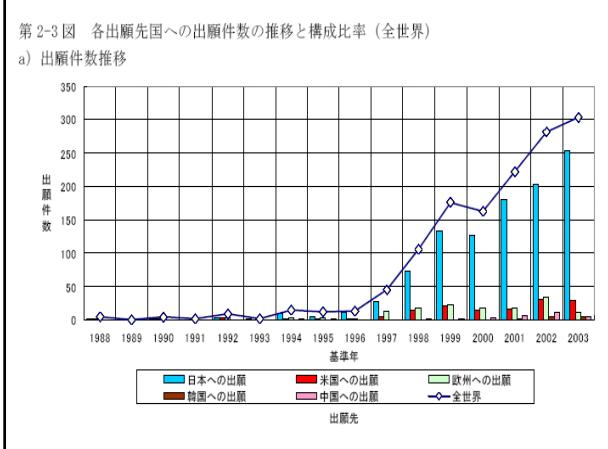
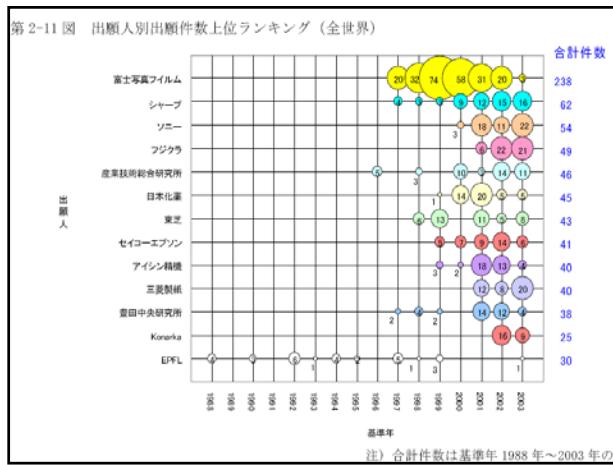
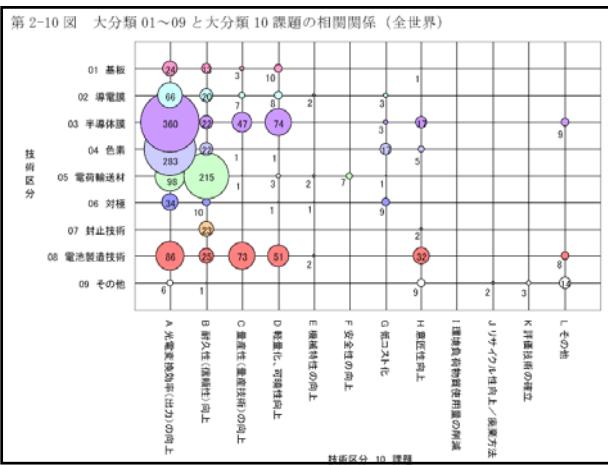
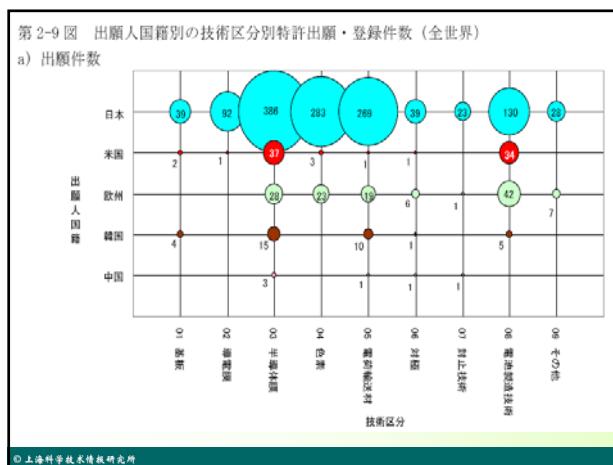
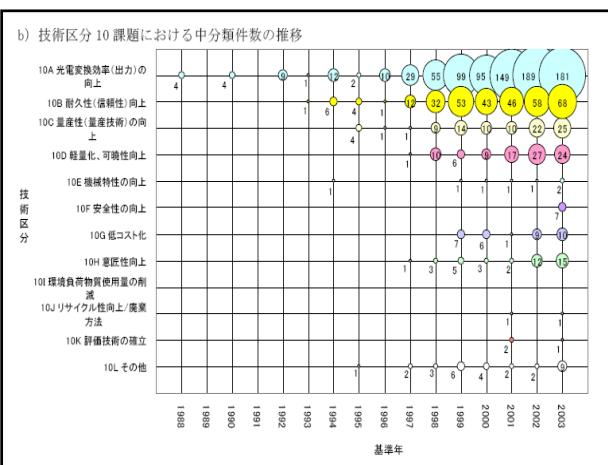
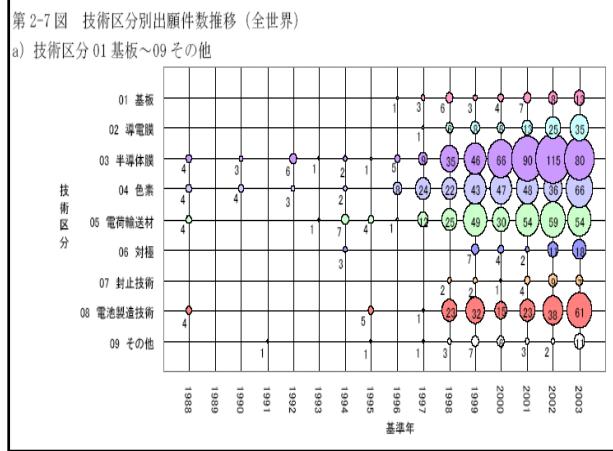
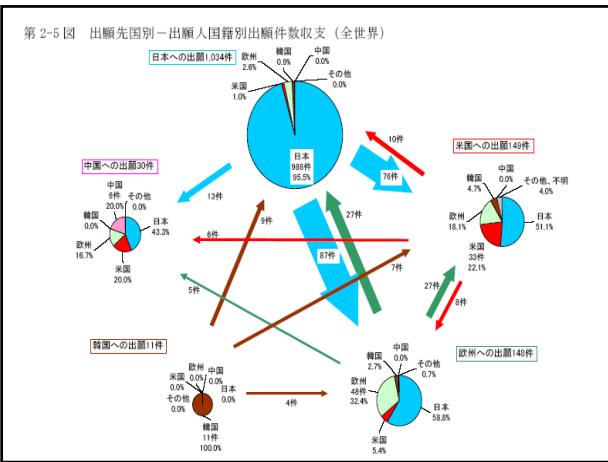


图 I-1-2 日本分類別			子分類	
01. 基盤	1. 有機基盤	1. ガラス基盤, 2. セラミック基盤, 3. 金属基盤, 4. 由縫基盤, 5. その他の基盤		
02. 等価物	1. 薄型等価物	1. 磁性, 2. 通気, 3. 防炎等の等価物	1. 磁性	1. 磁性, 2. 通気, 3. 防炎等, 4. その他
	2. 半導体等価物	1. 1-9のP(VDF共重合), 2. TiO ₂ , 3. CdO(120度), 4. ポーランド, 5. その他の半導体等価物	2. 半導体	1. 磁性, 2. 通気, 3. 防炎等, 4. その他, 5. その他の半導体等価物
	3. 光電変換等価物	1. 光電変換等価物	3. 光電変換等価物	1. 磁性, 2. 通気, 3. 防炎等, 4. その他の光電変換等価物
03. 半導体等	1. 半導体等	1. タリニア電極, 2. ネオジウムセリウム, 3. ナノセリウム, 4. ラクニコドビツビ, 4. 硅化への笠加熱, 5. 電極板等, 6. その他の半導体等	1. 半導体等	1. タリニア電極等, 2. ネオジウムセリウム, 3. その他の半導体等, 4. ラクニコドビツビ, 4. 硅化への笠加熱, 5. 電極板等, 6. その他の半導体等
	2. 液晶等	1. 液晶等	1. 液晶等	1. 液晶等, 2. 通気, 3. その他の液晶等
	3. 液性化成膜技術	1. リソングラフィー等	3. 液性化成膜技術	1. リソングラフィー等, 2. その他の液性化成膜技術
	4. 塗装	1. 塗装	1. 塗装	1. 塗装, 2. 通気, 3. 防炎等, 4. その他の塗装
	5. 色調	1. 色調	1. 色調	1. 色調, 2. 通気, 3. 防炎等, 4. その他の色調
	6. 密封等	1. 密封等	1. 密封等	1. 密封等, 2. 通気, 3. 防炎等, 4. その他の密封等
	7. 粘合等	1. 粘合等	1. 粘合等	1. 粘合等, 2. 通気, 3. 防炎等, 4. その他の粘合等
	8. 電線等	1. 電線等	1. 電線等	1. 電線等, 2. 通気, 3. 防炎等, 4. その他の電線等
	9. フレキシブル	1. フレキシブル	1. フレキシブル	1. フレキシブル, 2. 通気, 3. その他のフレキシブル
	10. 合成樹脂	1. 合成樹脂	1. 合成樹脂	1. 合成樹脂, 2. 通気, 3. 防炎等, 4. その他の合成樹脂
	11. 塑性加工	1. 塑性加工	1. 塑性加工	1. 塑性加工, 2. 通気, 3. 防炎等, 4. その他の塑性加工
	12. 加工	1. 加工	1. 加工	1. 加工, 2. 通気, 3. 防炎等, 4. その他の加工
	13. その他の出願	1. その他の出願	1. その他の出願	1. その他の出願





第2-18図 EPFLから出願されている特許のカバー範囲

